

型號：PF604-F4

編號	項目	規格	規範標準
1	外觀	表面光亮，無污染物。	
2	合金組成	錫 / 銅 0.7	JIS-Z-3282
3	液相溫度	約 227~228℃	使用 DSC 儀器
4	助錒劑含量	3.0 ± 1.0%	JIS-Z-3283
5	鹵素含量	0	BS EN 14582
6	比重	7.3	
7	擴散率	75% 以上	JIS-Z-3197
8	包裝重量	0.5、1、5、10 公斤/捲。	JIS-Z-3283
9	線徑容許誤差	0.3~0.6± 0.05 mm。0.8~3.0 ± 0.1 mm。	JIS-Z-3283
10	特性	銲接性能佳，銲後殘渣透明，無腐蝕性。銲接時，助錒劑不飛濺，無不良氣味，且無毒性氣體產生，不對人體造成傷害。	
11	用途	適合電子零件的銲接。	
12	保存方法	必須放置在乾燥且無腐蝕性與陽光照射之環境，使用期 2 年。	

信賴性測試

編號	測試項目	測試結果	測試方法
1	銅鏡試驗	PASS 銅鏡未透光	IPC-TM-650, 2.3.32
2	銅板腐蝕試驗	PASS 銅板未腐蝕	JIS-Z-3197,6.6.1
3	表面絕緣阻抗	PASS $1 \times 10^{10}$ 以上	IPC-TM-650, 2.6.3.3
4	電子遷移測試	PASS $1 \times 10^{10}$ 以上，無遷移現象。	IPC-TM-650, 2.6.14.1

合金組成標準範圍(%)

錫 (Sn)	銅 (Cu)	銀 (Ag)	鎳 (Ni)	鈹 (Bi)	鋅 (Zn)	鋁 (Al)	銻 (Sb)	鐵 (Fe)	砷 (As)	鎘 (Cd)	鉛 (Pb)	銦 (In)	金 (Au)
Rem.	0.5~ 0.9	0.1 MAX	0~ 0.01	0.1 MAX	0.001 MAX	0.001 MAX	0.05 MAX	0.02 MAX	0.03 MAX	0.002 MAX	0.05 MAX	0.10 MAX	0.05 MAX

本產品成份均完全符合歐盟 RoHS 與 SONY 綠色夥伴中特定有害物質管制之要求。

**Model: PF604-F4**

NO	Item	Specification	Standard
1	Appearance	Bright and shiny surface finishes.	
2	Alloy	Sn/ Cu0.7	JIS-Z-3282
3	Melting Point	227~228℃	DSC
4	Flux Content	3.0 ±1.0 %	JIS-Z-3283
5	Halide Content	0	BS EN 14582
6	Gravity	7.3	
7	Spread ability	> 75%	JIS-Z-3197
8	Packaging	0.5 、 1 、 5 、 10kg/Roll.	JIS-Z-3283
9	Diameters Tolerances	0.3~0.6± 0.05 mm. 0.8~3.0 ± 0.1 mm.	JIS-Z-3283
10	Features	Excellent solder joint reliability. Superior joint strength. Excellent thermal & Mechanical fatigue resistance. Low cleaning required after solder joint.	
11	Purpose	For use in applications requiring good activation.	
12	Storage, Handling, and Shelf Life:	Storage must be in a dry, non-corrosive and shine environment. Avoids the oxidant, the acid and the hydrogen peroxide. Shelf life is 2 years from date of manufacture.	

**Physical Properties & Reliability Data**

No	Test Item	Test Result	Test Method
1	Copper Mirror Test	PASS	IPC-TM-650, 2.3.32
2	Copper plate Corrosion	PASS	JIS-Z-3197, 6.6.1
3	S.I.R Test	PASS 1×10 <sup>10</sup> up	IPC-TM-650, 2.6.3.3
4	Electrochemical migration Test	PASS 1×10 <sup>10</sup> up	IPC-TM-650, 2.6.14.1

**Alloy Composition(%)**

Sn	Cu	Ag	Ni	Bi	Zn	Al	Sb	Fe	As	Cd	Pb	In	Au
Rem.	0.5~ 0.9	0.1 MAX	0~ 0.01	0.1 MAX	0.001 MAX	0.001 MAX	0.05 MAX	0.02 MAX	0.03 MAX	0.002 MAX	0.05 MAX	0.10 MAX	0.05 MAX

All alloy of SHENMAO' products were to conform to SONY Green Partner and comply RoHS requirement.